



OPA857-DIE

超低ノイズ、広帯域、フィードバック抵抗選択可能トランスインピーダンス・アンプ

1 特長

- 内部的なミッドスケール基準電圧
- 疑似差動出力電圧
- 広いダイナミック・レンジ
- クローズド・ループのトランスインピーダンス帯域幅:
 - 125MHz (5k Ω トランスインピーダンス・ゲイン、1.5pF外部寄生容量)
 - 105MHz (20k Ω トランスインピーダンス・ゲイン、1.5pF外部寄生容量)
- 非常に低い入力換算電流ノイズ(ブリックウォール・フィルタBW = 135MHz):
 - 15nA_{RMS} (20k Ω トランスインピーダンス)
- 非常に高速な過負荷回復時間: 25ns未満
- 内部の入力保護ダイオード
- 電源
 - 電圧: 2.7V~3.6V
 - 電流: 23.4mA
- 拡張温度範囲: -40°C~+85°C

2 アプリケーション

- フォトダイオード監視
- 高速I/V変換
- 光アンプ
- CATスキャナのフロント・エンド

3 概要

OPA857-DIEは広帯域、過負荷からの迅速な回復、高速なセトリング、超低ノイズの特長を持つトランスインピーダンス・アンプで、フォトダイオード監視アプリケーションを対象としています。フィードバック抵抗を選択可能なため、OPA857-DIEにより高性能光学システムを簡単に設計できます。過負荷からの回復時間が非常に短く、内部的な入力保護機能があるため、信号チェーンの他の部分をオーバードライブから保護するとともに、回復時間を最短にできます。2つのトランスインピーダンス・ゲイン構成を選択可能なため、今日のトランスインピーダンス・アンプのアプリケーションに要求される高いダイナミック・レンジと柔軟性を両立できます。

このデバイスは、完全な産業用温度範囲の-40°C~+85°Cで動作するよう特性付けされています。

Ordering Information⁽¹⁾

PRODUCT	PACKAGE DESIGNATOR	PACKAGE	ORDERABLE PART NUMBER	PACKAGE QUANTITY
OPA857-DIE	TD	Bare die in gel pak VR ⁽²⁾	OPA857TD1	324
			OPA857TD2	10

- (1) For the most current package and ordering information, see the Package Option Addendum at the end of this document, or see the TI web site at www.ti.com.
- (2) Processing is per the Texas Instruments commercial production baseline and is in compliance with the Texas Instruments Quality Control System in effect at the time of manufacture. Electrical screening consists of DC parametric and functional testing at room temperature only. Unless otherwise specified by Texas Instruments AC performance and performance over temperature is not warranted. Visual Inspection is performed in accordance with MIL-STD-883 Test Method 2010 Condition B at 75X minimum.



OPA857-DIE

JAJSCF2 – AUGUST 2016

www.ti.com

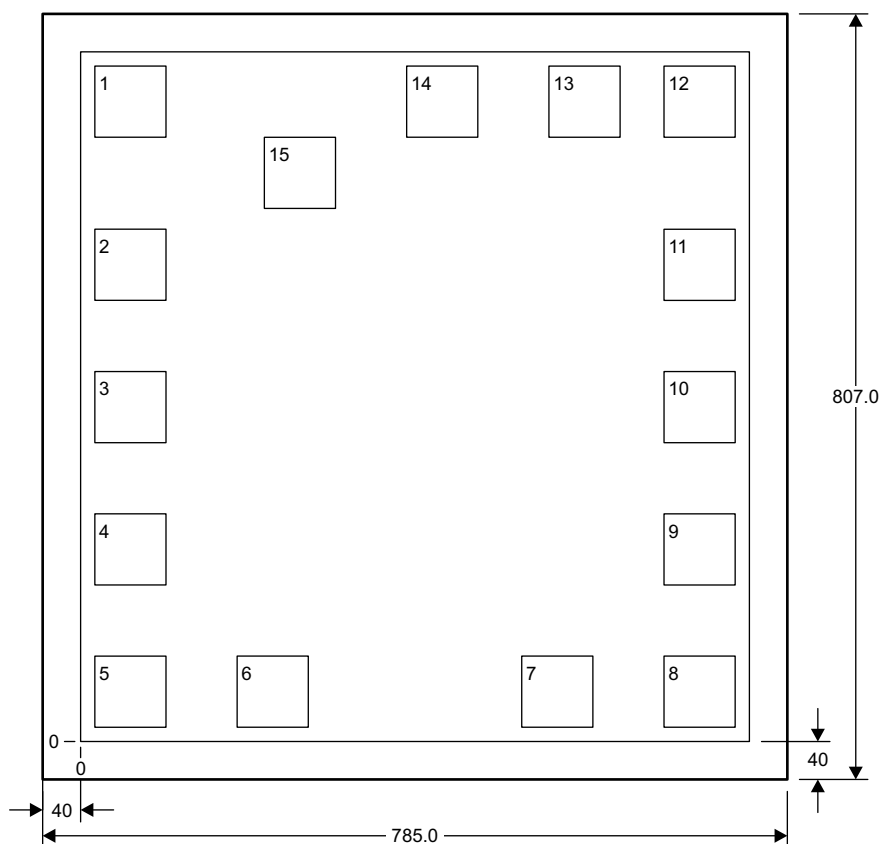


This integrated circuit can be damaged by ESD. Texas Instruments recommends that all integrated circuits be handled with appropriate precautions. Failure to observe proper handling and installation procedures can cause damage.

ESD damage can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may be more susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published specifications.

4 Bare Die Information

DIE THICKNESS	BACKSIDE FINISH	BACKSIDE POTENTIAL	BOND PAD METALLIZATION COMPOSITION	BOND PAD THICKNESS
15 mils.	Silicon with backgrind	GND	TiW/AlCu (0.5%)	1100 nm



Bond Pad Coordinates in Microns

NAME	PAD NUMBER	X MIN	Y MIN	X MAX	Y MAX	DESCRIPTION
GND	1	15	637	90	712	Ground
CTRL	2	15	465	90	540	Control pin for transimpedance gain. GND, logic 0 = 5-k Ω internal resistance; +V _S , logic 1 = 20-k Ω internal resistance.
GND	3	15	315	90	390	Ground
GND	4	15	165	90	240	Ground
OUTN	5	15	15	90	90	Common-mode voltage output reference
GND	6	165	15	240	90	Ground
GND	7	465	15	540	90	Ground
OUT	8	615	15	690	90	Signal output
+V _S	9	615	165	690	240	Supply voltage
+V _S	10	615	315	690	390	Supply voltage
+V _S	11	615	465	690	540	Supply voltage
GND	12	615	637	690	712	Ground
TESD_SD	13	493.7	637	568.7	712	Test mode enable. Connect to GND for normal operation, and connect to +V _S to enable test mode.
TEST_IN	14	343.7	637	418.7	712	Test mode input. Connect to +V _S during normal operation.
IN	15	193.7	561.95	268.7	636.95	Input

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
OPA857TD1	Active	Production	null (null) 0	324 OTHER	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	
OPA857TD1.B	Active	Production	null (null) 0	324 OTHER	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	
OPA857TD2	Active	Production	null (null) 0	120 OTHER	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	
OPA857TD2.B	Active	Production	null (null) 0	120 OTHER	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated